

一. 安規要求：		膠類料號
1.1 DC CORD、INLET WIRE近HOOK線外皮，不得因焊錫而有熔化之現象。 1.2 魚叉PIN焊接時避免燙傷絕緣片。 1.3 上鋁套組裝時需確認組裝定位，避免上下鋁套的接觸不良。 1.4 T050不能浮件，膠帶不可破損。 1.5 安規材料，依安規BOM表使用，不可代用。 1.6 PCB零件點膠位置如下 導熱膠：DIP面(圖A) 導熱膠：SMD(圖B)		
二. 客戶要求：		膠類料號
2.1 零件剪腳後須全部補焊。 2.2 補焊後須清除錫球，須檢查是否殘留錫球。 2.3 L/N/FG與AC INLET端子焊接處為夾焊。		
三. 設計性要求：		膠類料號
3.1 L001、L002、T050，不可浮件、歪斜，須和PCB 緊貼。 3.2 J1魚叉PIN附近有電阻R1，焊錫時需注意。 3.3 零件面點膠位置如下，點膠重量為12.6g($\pm 1g$)，位置參考圖(A)。 1. L002、C001與C051之間點膠 2. L002上方點膠，膠量需可觸及上鋁套，如圖(A) 3. C051上方點膠，膠量需可碰觸上鋁套 4. T050插件先於PCB上點膠後插件，如圖(C) 5. C051與T050之間點膠，膠量需附蓋T050出腳 6. CY1與T050之間點膠，膠量需碰觸FRPP並覆蓋CY1，高度與FRPP折角處齊平，如圖(A) 7. T050上方點膠，膠量需可觸碰上鋁套 3.4 SMD面點膠如下，點膠重量為6.7g($\pm 1g$)，位置參考圖(B)。 1. D050到Q050條狀區域上方點膠，要完全覆蓋Q050，膠量延伸至PCB板邊，如圖(B) 2. B051、D051、B052、C055及D052區域上方點膠，如圖(B) 3. T050出腳點膠 4. IC200、R200、R202與R307-1區域上方點膠，Q300上方覆蓋膠的面積要達一半，如圖(B) 5. IC100上方點膠，膠量延伸至PCB板邊，如圖(B) 6. 膠量需控制避免觸及魚叉PIN孔，也不可掩蓋LED200及周圍區域，如圖(B) 3.5 PCB與FRPP組裝時，需將FRPP上折不分插入PCB板定位在組裝下鋁套 3.6 組裝SHIELD-BTM時，魚叉PIN需確實插入PCB板後焊錫 3.7 C051下方貼醋酸膠帶(720289)33mm，需附蓋整個下半圓，突出2mm，如圖(D)		(738351) 14-SA07 (738351) 14-SA07
四. 其他要求：		膠類料號
4.1 超音波熔合Case上下蓋後，中線縫高度為0.15+0.15/-0.15mm 4.2 超音波熔合Case上下蓋後，SR端的上下蓋斷差小於0.4mm 4.3 超音波熔合Case上下蓋後，INLET端與外殼的間隙單邊小於0.4mm 4.4 DIP面零件高度不得大於19.23mm 4.5 SMD面零件出腳高度不得大於2.5mm 4.6 鋁套組裝後機芯高度(不含鋁套凸包)小於24.1mm		

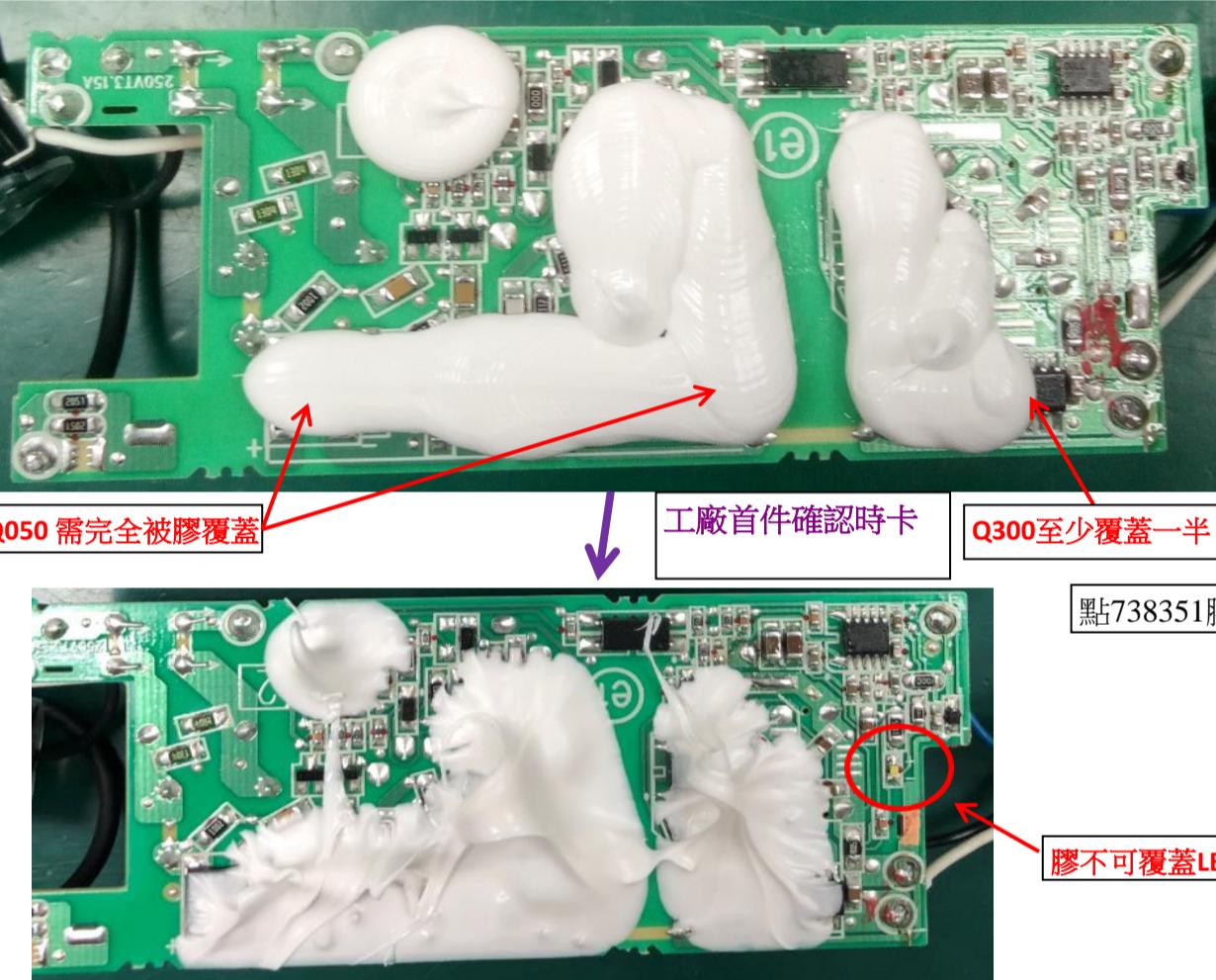
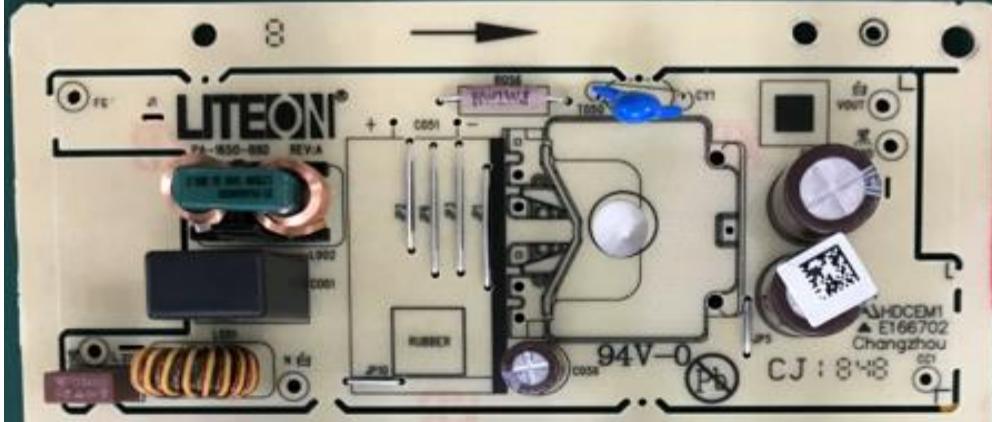
Prepared by: Jacky Tsai

Checked by:

Approved by:

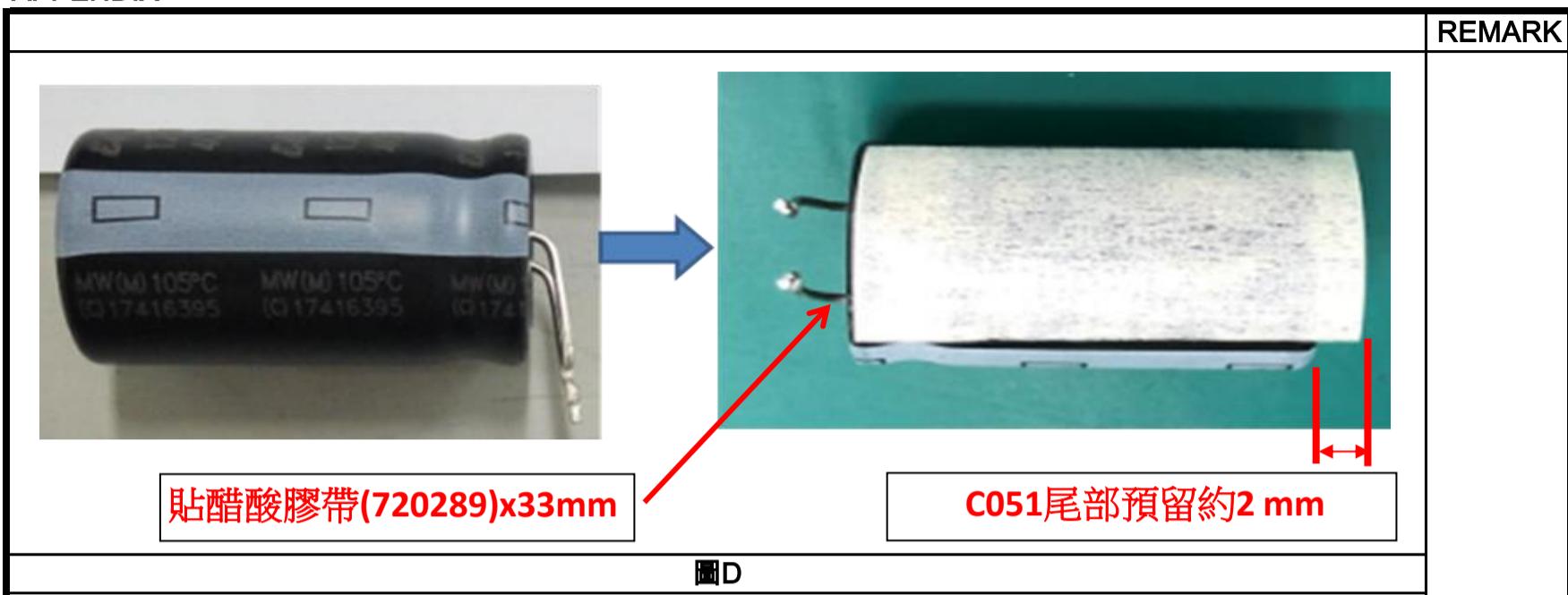
PA-1650-88D3 SPECIAL ASSEMBLING INSTRUCTION

APPENDIX

	REMARK
	點738351膠
	<p>D050、Q050 需完全被膠覆蓋</p> <p>工廠首件確認時卡</p> <p>Q300至少覆蓋一半</p> <p>點738351膠</p> <p>膠不可覆蓋LED</p>
	點738351膠

PA-1650-88D3 SPECIAL ASSEMBLING INSTRUCTION

APPENDIX



Componet Limit Height				
NO.	Name	C001 Dimension	C051 Dimension	T050 Dimension
H1	Adaptor height	28.00	28.00	28.00
1	Case top	1.80	1.80	1.80
1.1	Assembly Tolerance(Main body<->case Top)	0.20	0.20	0.20
2	Shielding TOP	0.30	0.00	0.30
2.1	Tape	0.12	0.12	0.12
3	Glue	0.00	0.10	0.20
4	PCB	1.00	1.00	1.00
4.1	C051 BTM Wire	0.00	0.70	0.00
4.2	C051 BTM Tape	0.00	0.30	0.00
5	Trimming free gap	2.50	2.50	2.50
6	FRPP	0.45	0.45	0.45
6.1	Tolerance(FRPP <-> Shielding BTM)	0.10	0.10	0.10
7	Shielding BTM	0.30	0.30	0.30
8	Component Height (MAX)	19.00	18.50	18.90
9.1	Assembly Tolerance(Main body<->case btm)	0.20	0.20	0.20
9	Case Btm	1.80	1.80	1.80
	Thickness TTL	23.77	24.07	23.87
	Component Limit Height (MAX)		19.23	

